

KINGFULL大瑞无铅 有铅 BGA锡球锡珠

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | KINGFULL大瑞无铅 有铅 BGA锡球锡珠 |
| 公司名称 | 深圳市金新福电子技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 种类:锡球 特性:优质焊接材料 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华街道龙观路狮头岭工业区3#厂房3层 |
| 联系电话 | 13525251255 13560770980 |

产品详情

深圳金福电子，长期供应 正品 大瑞bga锡球，无铅锡球。（大量库存，现货）

可以为客户提供常备合金包括有铅：sn63pb37

无铅合金：sn96.5ag3cu0.5

其他合金需要预定。

可以为客户提供的常备锡球规格：0.76mm-0.25mm

包装方式有：25万/瓶 50万/瓶 1百万/瓶

大瑞成立于2000年.公司已通过iso9000:2001和iso14001:2004及iso/ts16949:2002等严格的质量认证.

大瑞第一家通过ts16949认证的bga锡球制造商.

球径公差最严格.内控公差仅8微米.

产品添加微量元素.提高锡球抗氧化能力及可靠度.

包装材料使用抗氧化材料且符合rohs要求.

大瑞公司bga锡球产品已通过全球多家封装厂认证及采购.

本产品的加工定制是否，种类是锡球，特性是优质焊接材料，用途是半导体封装，BGA返修